捷邦精密科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：高精密电子功能结构件生产基地建设项目；

2、新增募投项目情况：本次变更募集资金用途为向捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简称“东莞赛诺”）和公司控股孙公司扬州赛诺高德电子科技有限公司（以下简称“扬州赛诺”）（以下统称“赛诺高德”）提供借款以实施新增募投项目“精密金属蚀刻件建设项目”（以下简称“新增募投项目”）；

3、变更部分募集资金投向的金额：本次拟变更原募投项目募集资金金额为14,000.00万元，变更涉及的资金总额占原募投项目拟投入募集资金金额39.77%，占公司首次公开发行股票募集资金净额的16.73%；新增募投项目总投资金额为26,713.53万元，投资总额超出募集资金投入部分将以实施主体通过自有或自筹资金方式解决；

4、新增募投项目实施主体：公司控股子公司东莞赛诺和公司控股孙公司扬州赛诺；

5、本次变更部分募集资金用途并向控股子公司东莞赛诺和控股孙公司扬州赛诺提供借款以实施募投项目的事项尚需提交公司股东大会审议。

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开

第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更部分募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,810.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币51.72元/股，募集资金总额936,132,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币836,950,333.22元。募集资金已于2022年9月14日划至公司指定账户，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《捷邦精密科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]41117号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目使用计划，截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金	截至2025年6月30日累计投入募集资金金额
1	高精密电子功能结构件生产基地建设项目	37,200.00	35,200.00	11,358.52
2	研发中心建设项目	9,800.00	9,800.00	-
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	合计	57,000.00	55,000.00	21,358.52

（三）本次拟变更募集资金用途情况

根据募投项目的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”部分募集资金用途，用于向公司控股子公司东莞赛诺和公司控股孙公司扬州赛诺提供借款以实施新增

募投项目“精密金属蚀刻件建设项目”。拟变更原募投项目募集资金金额为14,000.00万元,变更涉及的资金总额占原募投项目拟投入募集资金金额39.77%,占公司首次公开发行股票募集资金净额的16.73%。本次调整后,公司首次公开发行股票募投项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	变更前		变更后	
			总投资	拟使用募集资金	总投资	拟使用募集资金
1	高精密电子功能结构件生产基地建设项目	捷邦精密科技股份有限公司、资阳捷邦精密科技有限公司、昆山尚为新材料有限公司、J.POND PRECISION TECHNOLOGY (VIETNAM) CO.,LTD	37,200.00	35,200.00	37,200.00	21,200.00
2	精密金属蚀刻件建设项目	东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司、扬州赛诺高德电子科技有限公司	-	-	26,713.53	14,000.00
3	研发中心建设项目	资阳捷邦精密科技有限公司	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
4	补充流动资金项目	捷邦精密科技股份有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计			57,000.00	55,000.00	83,713.53	55,000.00

注:公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》,同意“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”增加公司、公司子公司昆山尚为新材料有限公司和J.POND PRECISION TECHNOLOGY (VIETNAM) CO.,LTD作为实施主体并相应增加实施地点。

二、变更部分募集资金用途的原因

(一) 原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划投资情况

公司首次公开发行股票募投项目之一“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”原总投资额为37,200.00万元,拟使用募集资金金额为35,200.00万元,该项目规划建设期为2年,实施主体为公司全资子公司资阳捷邦精密科技有限公司。具体情况如下:

(1) 原募投项目具体投资概算如下表所示:

序号	投资项目	投资金额(万元)	占比
----	------	----------	----

序号	投资项目	投资金额（万元）	占比
一	建设投资	34,340.81	92.31%
1	建筑工程费	9,866.70	26.52%
2	设备购置及安装费	21,442.51	57.64%
3	工程建设其他费用	487.84	1.31%
4	预备费	2,543.76	6.84%
二	铺底流动资金	2,859.19	7.69%
合计		37,200.00	100.00%

(2) 2023年4月，公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，将该募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日。之后分别于2023年8月和2024年11月对该募投项目进行重新论证，决定暂缓实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”。

2、原募投项目实际投资情况

截至2025年6月30日，“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”累计投入募集资金金额为11,358.52万元。

(二) 变更部分募集资金用途的原因

原募投项目“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”是基于当时消费电子产品更新迭代速度加快、下游市场需求旺盛的行业趋势及公司发展战略制定，该募投项目已在前期经过充分的可行性论证。但在实际执行过程中，由于相关产品市场需求变化，为更好地保护公司及投资者的利益，公司谨慎推进原募投项目的投资建设。随着消费电子产品向智能化、轻薄化发展，汽车电子化程度不断深化，下游市场对精密金属蚀刻的需求快速增长。根据公司战略布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度，公司拟将部分募集资金投向新增募投项目“精密金属蚀刻件建设项目”，以进一步推进公司在消费电子及汽车领域的布局，抓住市场机遇，提高募集资金的使用效率与投资回报。同时，原募投项目“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”继续实施并增加部分募投项目实施主体及实施地点。

三、新增募投项目情况

(一) 项目基本情况

- 1、项目名称：精密金属蚀刻件建设项目；
- 2、实施主体：公司控股子公司东莞赛诺和公司控股孙公司扬州赛诺；
- 3、实施地点：东莞市谢岗镇谢曹路 788 号汇合智慧产业园和扬州市高邮经济开发区波司登大道南侧 3 号
- 4、投资计划：新增募投项目总投资 26,713.53 万元，拟使用变更后的募集资金为 14,000.00 万元，不足部分由东莞赛诺和扬州赛诺通过自有或自筹资金方式解决。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
1	建设投资	25,713.53	96.26%
1.1	工程费用	24,489.08	91.67%
1.1.1	场地装修	3,245.92	12.15%
1.1.2	设备购置费	21,243.16	79.52%
1.2	预备费	1,224.45	4.58%
2	铺底流动资金	1,000.00	3.74%
3	项目总投资	26,713.53	100.00%

（二）项目必要性分析

1、抓住消费电子产业升级机遇，扩大精密蚀刻件供应能力

随着 5G、人工智能、物联网等技术的快速发展，全球消费电子产业正经历深刻的技术变革和升级换代。高端消费电子产品如智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等在功能集成度、运算性能、散热效率等方面的技术要求日益严苛，对精密金属部件的性能标准不断提升。比如为满足产品轻薄化、高性能化的设计要求，智能手机内部大量采用精密蚀刻工艺制造的散热组件、电磁屏蔽罩、精密连接器等关键部件，这些部件需要达到微米级加工精度和复杂三维结构。此外，新一代智能终端设备的精密铰链系统也要求金属部件具备极高的强度、耐久性和加工精度，精密蚀刻工艺在此领域具有独特优势。智能穿戴设备由于空间极度受限，更多依赖精密蚀刻工艺制造超薄金属网格、精密孔阵列等结构复杂的金属部件。消费电子产品功能升级直接带动了对高精度精密金属蚀刻件需求的快速增长。

此外，消费电子产品轻薄化、集成化趋势使得传统冲压工艺在超薄壁厚、复杂几何形状、高精度公差等方面存在技术局限，精密蚀刻工艺凭借其无机械应力、

高精度、一致性好的优势，在高端领域获得更多应用机会。赛诺高德可通过本次项目，有效扩大精密金属蚀刻产能，有助于赛诺高德抓住产业升级机遇，巩固和扩大在高端消费电子供应链中的市场地位。

2、契合汽车电子发展需求，强化汽车产业链布局

汽车产业正经历电动化、智能化的深刻变革，新能源汽车快速发展推动电池热管理系统、电机控制单元、车载充电系统等核心电子部件大量应用，汽车电子在整车成本中的占比持续提升。汽车电子产品对精密金属部件的可靠性、耐久性要求极高，同时在轻量化、小型化、集成化方面也提出了更严苛的技术标准。在此背景下，汽车电子产品对精密金属部件的需求正在快速增长。

电池热管理系统需要大量散热片和导热板，这些部件必须具备复杂的微通道结构以提高散热效率；电机控制器中的屏蔽罩、连接件等对加工精度和产品一致性有着严格要求；车载电子设备的外壳、支架等结构件也日益复杂化。传统机械加工在面对这些复杂结构和高精度要求时往往力不从心，而精密蚀刻工艺能够精确控制尺寸公差，高效制造复杂几何结构，更好地满足汽车电子产品的技术要求。

赛诺高德已成功进入汽车供应链体系，产品最终应用于多个知名汽车品牌，在汽车电子精密制造领域积累了丰富的经验和客户资源。通过本次项目的实施，赛诺高德可进一步扩大汽车电子领域的产能布局，满足汽车电子产业发展对高品质精密蚀刻件的旺盛需求，强化在汽车产业链中的地位，为赛诺高德长期可持续发展奠定坚实基础。

3、提升核心技术竞争优势，强化产品优势

精密金属蚀刻行业技术壁垒持续攀升，尤其在集成电路制程迈向纳米级和3D堆叠技术下，对蚀刻设备和工艺的要求越来越严苛。客户也对供应商的技术水平、产品质量、交付能力和成本控制能力提出了更高要求。赛诺高德深耕消费电子、汽车电子等高端制造领域，在金属蚀刻细分领域技术实力雄厚，但面对竞争日益激烈的市场环境，赛诺高德必须持续加大技术创新投入和产能建设力度。

本次将引入更加先进的蚀刻生产设备和检测设备，打造符合更高标准的洁净车间和生产环境，在设备技术水平和生产条件方面实现显著提升。先进设备的引入将提升赛诺高德在超精密蚀刻、多层复合结构蚀刻、特殊材料蚀刻等高端技术领域的加工能力和产品精度，洁净车间的建设将为高品质产品生产提供更加稳定

可控的环境保障。通过建设本项目，赛诺高德产品在精度、一致性、可靠性等关键指标方面将获得进一步提升，从而强化产品技术优势和市场竞争力。同时，通过规模化生产降低单位成本，提高产品性价比，在激烈的市场竞争中保持和扩大技术领先优势，确保赛诺高德在金属蚀刻赛道的领先地位不断巩固和提升。

（三）项目可行性分析

1、下游行业景气度高，为项目产能消纳提供保障

精密蚀刻件下游应用行业整体景气度较高，市场容量持续扩大。全球消费电子市场经过前期调整后正步入复苏通道，智能终端产品更新换代周期加快，带动精密结构件需求回升。新兴应用领域如折叠屏设备、AR/VR 产品、智能穿戴等快速发展，为精密蚀刻工艺开辟了新的增长空间。汽车电动化转型持续深化，新能源汽车渗透率不断提升，汽车电子化程度加深为精密金属部件创造了巨大市场增量。

从产业发展阶段看，精密蚀刻行业仍处于成长期，市场集中度相对较低，为优质企业提供了广阔的发展空间。随着终端产品技术要求的不断提升，传统加工工艺难以满足高精度、复杂结构的制造需求，精密蚀刻工艺的替代效应日益显现。赛诺高德在蚀刻细分的领域具备技术领先优势和优质客户资源，赛诺高德已成功进入消费电子及汽车领域头部企业的供应链体系，具备充分的市场竞争力，项目建成后的产能消纳具有可靠保障。

2、强大的技术实力为项目实施提供技术保障

赛诺高德深耕精密金属蚀刻技术，经过多年技术积累，在图形精度控制、药水配方优化、自动化生产以及特殊材料蚀刻等核心技术方面已具备行业领先优势。在高精度精密蚀刻领域，赛诺高德依托自主研发的核心技术，成功解决了钛合金等特殊材料的蚀刻制备难题，实现了微米级精度控制和产品一致性，可精准满足高端消费电子和汽车电子客户的严苛要求。

赛诺高德已构建了独立自主的核心技术体系，截至 2025 年 6 月 30 日，赛诺高德及子公司拥有专利权 74 项，其中发明专利 11 项，并参与制定了“半导体器件栅介质层的时间相关介电击穿（TDDB）试验 20213173-T-339”和“镍和铜电铸工艺规范 GB/T45376-2025”等行业标准。赛诺高德还获得了“专精特新‘小巨人’企业”称号，在精密蚀刻细分领域具有重要技术影响力。赛诺高德始终高度重视

技术研发，持续加大投入，注重技术规划、人才培养及机制建设，通过对技术人员多年的培养及储备，已拥有一支专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的技术团队。赛诺高德技术创新与工艺开发并行，内部研发与产业化深度融合，积累了丰富的工艺和技术经验，为新增募投项目的顺利实施提供了坚实技术保障。

3、丰富的生产经验与完善的质量控制体系保障项目顺利实施

赛诺高德在金属蚀刻规模化生产方面积累了丰富的经验，建立了标准化、规模化的生产管理体系。赛诺高德坚持使用行业先进的蚀刻设备制造产品、注重现场管理的持续改善、长期推动员工素养提升、始终保持质量上的高标准，建设了行业先进的蚀刻生产线。

赛诺高德拥有经验丰富的技术团队和管理团队，在精密金属蚀刻领域拥有多年的研发和生产经验。赛诺高德团队建设项目经验丰富，能够对项目建设流程和关键环节实现精准把控，有效控制项目进度和质量，保障项目顺利实施。

（四）项目预计经济效益

新增募投项目预计税后内部收益率为 20.70%，税后静态投资回收期为 5.47 年。

本次变更能够有效提高募集资金的使用效率，满足公司的发展需要，强化公司盈利能力，提高股东回报。

四、新增募投项目的风险提示

（一）项目效益不达预期的风险

本次新增募投项目的建设是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但项目实施过程中可能面临宏观环境变化、技术更新迭代、市场竞争加剧、内部管理等内外部因素影响，存在项目实施后经济效益不达预期的风险。

（二）管理风险

随着新增募投项目的实施，公司资产和经营规模将大幅增加，这将对公司的经营管理、内部控制、市场开拓等方面提出更高的要求，如果公司的管理制度和管理水平不能适应公司规模和产能迅速扩张的需要，将使公司一定程度上面临经营规模扩大带来的管理风险，进而对公司的盈利能力造成不利影响。同时，新增募投项目涉及新建生产线、设备采购安装、人员招聘培训等多个环节，项目管理复杂度较高。如果项目管理不当，可能出现建设进度延误、成本超支、质量不达

标等问题，影响项目预期效果。此外，项目建成后需要大量专业技术人员和管理人员，如果人才储备不足，可能影响项目正常运营。

（三）政策风险

新增募投项目部分实施主体尚未取得环评批复文件。如因国家或地方有关政策调整、项目等实施条件发生变化，可能存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。

（四）原材料价格波动风险

新增募投项目原材料主要为铜合金、钛合金等金属资源类以及蚀刻液等化工产品。采购价格随市场行情波动。原材料价格的波动不仅影响公司的成本控制，还增加了公司采购决策的难度。如果未来原材料价格出现大幅上涨，公司成本压力将显著增加，可能对公司利润水平产生不利影响。

（五）技术风险

精密蚀刻技术对工艺精度和稳定性要求极高，涉及复杂的化学反应过程和精密的设备控制。项目实施过程中，可能面临新设备调试、工艺参数优化、技术人员培训等技术风险。如果技术问题不能及时解决，可能影响产品质量和生产效率，进而影响项目预期收益。此外，随着下游产品技术升级，对精密蚀刻工艺提出更高要求，如果赛诺高德技术升级跟不上市场需求变化，可能面临技术落后的风险。

五、使用部分募集资金向控股子公司和控股孙公司提供借款具体情况

公司新增募投项目“精密金属蚀刻件建设项目”的实施主体为公司控股子公司东莞赛诺和控股孙公司扬州赛诺。

为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金对东莞赛诺和扬州赛诺合计提供 14,000.00 万元的借款（实际金额以实施变更时的具体金额为准）。本次借款利率将根据借款使用和资金到位时间，按照年利率 3.2% 计算，借款期限自借款发放之日起不超过 3 年，到期后经双方协商一致可续期。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。东莞赛诺其他股东未就本次借款事项提供同比例借款。

“精密金属蚀刻件建设项目”实施主体及借款对象的基本情况如下：

（一）东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司

1、基本情况

公司名称：东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4X2QUR89

成立日期：2017年9月4日

法定代表人：王友春

注册资本：3631.4272万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：金属蚀刻技术研发；手机及笔电均温板蚀刻件、全自动卷对卷蚀刻件、半导体引线框架、光学掩模版、汽车音响网、汽车装饰件、真空镀膜件、五金、电子产品的研发、生产、加工、销售；批发、零售：医疗器械（第二类医疗器械）；蚀刻技术转让、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

公司持有东莞赛诺 49.90%股权，东莞赛诺董事会过半数董事及财务总监均由公司委派，东莞赛诺为公司控股子公司。

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
捷邦精密科技股份有限公司	1,812.0884	49.90%
王友春	1,258.8838	34.67%
王志超	242.9126	6.69%
南京赛诺创业投资合伙企业（有限合伙）	106.7639	2.94%
张亮旗	88.0098	2.42%
谢云飞	65.22	1.80%
东莞粤海银瓶发展有限公司	39.9457	1.10%
王辉	17.6030	0.48%
合计	3,631.4272	100.00%

3、主要财务指标

单位：元

科目	2025.06.30	2024.12.31
资产总额	533,947,999.52	400,890,742.92

负债总额	298,411,368.60	168,163,747.47
净资产	235,536,630.92	232,726,995.45
科目	2025年1-6月	2024年度
营业收入	46,308,811.16	201,608,645.63
利润总额	542,228.93	-217,330.04
净利润	440,264.58	1,111,336.33

注：2025年6月30日财务数据未经审计，2024年度财务数据已经审计。

（二）扬州赛诺高德电子科技有限公司

1、基本情况

公司名称：扬州赛诺高德电子科技有限公司

统一社会信用代码：91321084MA20RUJK4C

成立日期：2020年1月9日

法定代表人：王友春

注册资本：12,814万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电子产品的研发、制造、加工，金属蚀刻技术研发；5G散热片（VC蚀刻）、笔记本、电脑配件、五金、汽车配件、汽车音响网、汽车内饰件、精密五金件制造、加工，阳极氧化、蚀刻、喷涂、CNC、冲压、PVD五金加工，销售本公司自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

东莞赛诺持有扬州赛诺100%股权，扬州赛诺为公司控股孙公司。

3、主要财务指标

单位：元

科目	2025.06.30	2024.12.31
资产总额	360,251,317.32	145,917,280.29
负债总额	292,661,572.70	69,258,856.44
净资产	67,589,744.62	76,658,423.85
科目	2025年1-6月	2024年度

营业收入	63,625,125.78	60,559,496.71
利润总额	-194,056.67	-20,743,458.18
净利润	-196,122.48	-21,626,978.35

注：2025年6月30日财务数据未经审计，2024年度财务数据已经审计。

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关要求规范使用募集资金。公司将新增募投项目开设募集资金专项账户，本次借款到位后，将存放于在银行开设的募集资金专项账户中。公司将按照相关规定，分别与东莞赛诺和扬州赛诺、保荐机构及募集资金存管银行签订监管协议，并提请股东大会授权公司管理层全权办理后续具体工作，包括但不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等事项。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》。董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司发展战略和项目实际情况而做出的调整，有利于提升公司募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划。因此，董事会同意公司变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规

定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形。因此，公司监事会同意变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的事项已经第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，除尚需股东大会审议外，已履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次事项是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况，不影响前期保荐意见的合理性。

综上所述，保荐机构对变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

七、备查文件

- （一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- （二）捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
- （三）中信建投证券股份有限公司出具的《关于捷邦精密科技股份有限公司变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日